

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 27 年 7 月 9 日 (2015.7.9)

【公開番号】特開 2014-22654 (P2014-22654A)
【公開日】平成 26 年 2 月 3 日 (2014.2.3)
【年通号数】公開・登録公報 2014-006
【出願番号】特願 2012-161836 (P2012-161836)
【国際特許分類】

H 0 5 K 3/46 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K	3/46	Z
H 0 5 K	3/46	B
H 0 5 K	3/46	Q

【手続補正書】
【提出日】平成 27 年 5 月 25 日 (2015.5.25)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項 1】

コア層を挟み、一方の面に電源層、他方の面にグランド層が積層され、更に、少なくとも前記電源層側に、絶縁層を間に介在させて複数の信号配線層が積層された多層構造のプリント基板であって、

前記複数の信号配線層のうち、前記電源層に隣接する信号配線層は信号配線パターンが設けられており、

前記電源層の前記信号配線パターンと対向する領域に、グランドプレーンを形成し、
前記信号配線パターンの両側で、前記信号配線パターンに対して前記グランドプレーンと反対側に位置する信号配線層にバイパスコンデンサを設け、

前記バイパスコンデンサが、前記グランド層と前記グランドプレーン、及び前記電源層に電氣的に接続されていることを特徴とするプリント基板。

【請求項 2】

前記グランド層と前記グランドプレーンは、少なくとも 2 箇所においてビア接続されていることを特徴とする請求項 1 に記載のプリント基板。

【請求項 3】

前記バイパスコンデンサが複数設けられた信号配線層に、該各バイパスコンデンサの間に位置するようにしてグランドパターンを形成し、前記信号配線パターンの周囲を囲むようにして前記グランドプレーンと前記グランドパターンとが少なくとも 2 箇所においてビア接続されていることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載のプリント基板。

【請求項 4】

請求項 1 乃至 3 のいずれか一項に記載のプリント基板が搭載されていることを特徴とする電子機器。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0008
【補正方法】変更
【補正の内容】

【０００８】

前記目的を達成するために本発明に係るプリント基板は、コア層を挟み、一方の面に電源層、他方の面にグランド層が積層され、更に、少なくとも前記電源層側に、絶縁層を間に介在させて複数の信号配線層が積層された多層構造のプリント基板であって、前記複数の信号配線層のうち、前記電源層に隣接する信号配線層は信号配線パターンが設けられており、前記電源層の前記信号配線パターンと対向する領域に、グランドプレーンを形成し、前記信号配線パターンの両側で、前記信号配線パターンに対して前記グランドプレーンと反対側に位置する信号配線層にバイパスコンデンサを設け、前記バイパスコンデンサが、前記グランド層と前記グランドプレーン、及び前記電源層に電氣的に接続されていることを特徴としている。

【手続補正３】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００９

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００９】

本発明に係るプリント基板は、電源層の信号配線パターンと対向する領域に、グランドプレーンを形成し、信号配線パターンの両側で、この信号配線パターンに対してグランドプレーンと反対側に位置する信号配線層にバイパスコンデンサを設け、バイパスコンデンサが、グランド層とグランドプレーン、及び電源層に電氣的に接続されている。